

MEIKO REPORT

第47期 株主通信

(2021年4月1日から2022年3月31日)

証券コード：6787

株式会社 **メイコー**

財務ハイライト

売上高

151,275 百万円

営業利益

13,255 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益

11,451 百万円

連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前期末 2021年3月31日現在	当期末 2022年3月31日現在
資産の部		
流動資産	66,338	78,367
固定資産	75,701	89,961
有形固定資産	68,786	82,562
無形固定資産	927	954
投資その他の資産	5,987	6,444
資産合計	142,040	168,328
負債の部		
流動負債	59,182	73,027
固定負債	42,247	36,615
負債合計	101,429	109,642
純資産の部		
株主資本	36,256	45,464
資本金	12,888	12,888
資本剰余金	6,464	6,700
利益剰余金	17,648	28,061
自己株式	△745	△2,186
その他の包括利益累計額	4,161	13,024
その他有価証券評価差額金	39	4
繰延ヘッジ損益	250	△41
為替換算調整勘定	4,127	13,173
退職給付に係る調整累計額	△255	△112
純資産合計	40,610	58,686
負債純資産合計	142,040	168,328

連結損益計算書

(単位：百万円)

	前期(累計) 2020年4月1日～ 2021年3月31日	当期(累計) 2021年4月1日～ 2022年3月31日
売上高	119,257	151,275
売上原価	101,732	123,880
売上総利益	17,524	27,394
販売費及び一般管理費	10,866	14,139
営業利益	6,657	13,255
営業外収益	795	2,090
営業外費用	1,755	1,050
経常利益	5,697	14,294
特別利益	3	12
特別損失	641	1,694
税金等調整前当期純利益	5,059	12,612
法人税等	422	1,175
当期純利益	4,636	11,436
非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△4	△14
親会社株主に帰属する当期純利益	4,640	11,451

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前期(累計) 2020年4月1日～ 2021年3月31日	当期(累計) 2021年4月1日～ 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,853	13,975
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,489	△11,785
財務活動によるキャッシュ・フロー	△618	△4,730
現金及び現金同等物に係る換算差額	501	869
現金及び現金同等物の期首残高	13,646	12,121
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	229	—
現金及び現金同等物の期末残高	12,121	10,450

財務のポイント

●連結損益計算書

受注面では、自動車の減産やスマートフォンの減産の影響が年度後半にみられました。販売面では、車載向け基板が顧客内のシェア拡大に加え、電装化により需要拡大が継続しました。収益面では、各工場の高稼働が継続するなか、全社的なコスト削減策や歩留まり改善策等により好調に推移しました。これに加え、為替が円安で推移したことにより当連結会計年度の売上高と利益は過去最高を更新しました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高151,275百万円(前期比26.8%増)、営業利益13,255百万円(同99.1%増)、経常利益14,294百万円(同150.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益11,451百万円(同146.7%増)となりました。

●連結貸借対照表

総資産は168,328百万円となり、前連結会計年度末に比べ26,288百万円増加しました。これは流動資産において現金及び預金が1,671百万円減少、受取手形及び売掛金が6,245百万円増加、棚卸資産が7,610百万円増加、固定資産において有形固定資産が13,775百万円増加が主な要因です。

純資産は58,686百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,075百万円増加しました。これは利益剰余金が10,413百万円増加、自己株式の取得等による1,441百万円減少、為替換算調整勘定が9,046百万円増加が主な要因です。



株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2022年3月期の業績についてご報告申し上げます。

代表取締役社長 **名屋 佑一郎**

2022年3月期 連結実績

(単位: 億円)

	2021年3月期実績		前期比 増減率	2022年3月期実績		前期比 増減率
	2021年3月期 実績	2022年3月期 実績		2022年3月期 実績	2023年3月期 予想	
売上高	1,193	1,513	26.8%	1,700	12.4%	
営業利益	67 5.6%	133 8.8%	99.1%	155 9.1%	16.9%	
経常利益	57 4.8%	143 9.5%	150.9%	145 8.5%	1.4%	
親会社株主に帰属する 当期純利益	46 3.9%	115 7.6%	146.7%	122 7.2%	6.5%	
期中平均為替レート (JPY/USD)	105.93	113.06		122.00		

2022年3月期 商品別収益実績

(単位: 億円)

	2021年3月期実績		2022年3月期実績		2023年3月期予想	
	売上	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 率(%)
車載	523	36 6.9%	732	63 8.6%	860	77 8.7%
スマートフォン タブレット	288	21 7.3%	332	39 11.7%	365	44 12.1%
半導体パッケージ		-		-	5	-6 -120.0%
SSD IoTモジュール	70	9 12.9%	86	11 12.8%	98	15 15.3%
A家電・アミューズメント 産機他商品	196	1 0.5%	237	17 7.2%	226	21 9.3%
EMS	116	0 0.0%	126	3 2.4%	146	6 4.1%
合計	1,193	67 5.6%	1,513	133 8.8%	1,700	155 9.1%

中期業績予想

18.3-22.3 売上年平均成長率8.7%

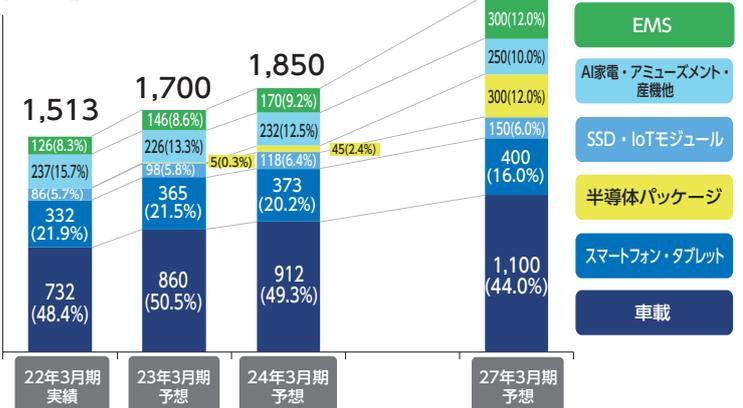
22.3-27.3 売上年平均成長率10.6%

(単位: 億円)



中期経営計画 商品別売上推移

(単位: 億円)



通期の業績について

当連結会計年度における電子部品業界は、半導体不足や世界的なサプライチェーンの混乱により、自動車をはじめとする最終製品の減産につながるなど混乱が見られました。今後も新型コロナウイルス感染症対策のロックダウンに起因する生産調整や、ウクライナ情勢等による資源価格やエネルギー価格の上昇等による生産コストの高騰など不透明感は継続しております。

このような状況の中、当社グループでは、受注面は自動車の減産や中国ロックダウンによるスマートフォンの減産の影響が年後半にみられました。販売面では、車載向け基板は顧客内のシェアが拡大していることに加え、電装化による需要拡大が継続しました。スマートフォン向け基板においても顧客内シェアが拡大し、これ以外の商品においても全般的に販売が増加しました。収益面では、各工場の高稼働が継続する中、全社的なコスト削減策や歩留まり改善等の施策により好調に推移しました。これに加え、為替が円安で推移したことにより当連結会計年度の売上高と利益は過去最高を更新しました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、151,275百万円(前期比26.8%増)と前期と比べ32,018百万円の増収となりました。損益面では、営業利益が13,255百万円(前期比99.1%増)、経常利益が14,294百万円(前期比150.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益が11,451百万円(前期比146.7%増)となりました。

2023年3月期の見通し

当社グループが属する電子部品業界は、自動車のEV化や電装化の進行による需要の拡大をはじめ、あらゆるものがネットにつながるIoT化の進行など様々な用途で需要が拡大する見通しとなっております。一方で、資源価格やエネルギー価格の高騰、中国におけるロックダウンへの対応など、サプライチェーンを維持するための取り組みとしてBCP体制の強化が課題となっております。

次期の当社グループの業績の見通しは、販売面においては車載向けの基板が引き続き全体を牽引しますが、スマートフォンや通信モジュール、EMS事業での販売拡大を見込んでおります。また、今後車載や半導体パッケージ・モジュール基板の需要が高まることから、需要拡大にも対応するため、天童工場、石巻第2工場、ベトナム第3工場などへの投資を拡大することといたしました。こうした投資を通じて当社事業の柱として育成するべく生産体制の強化を図ってまいります。収益面では工場の自動化・省人化投資や歩留まり改善などを通じてさらなる収益性の強化を図ってまいります。

中期経営計画 計画の概要

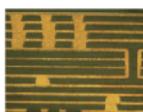
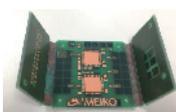
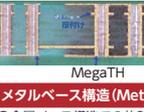
当社は、「モノづくりを通してお客様に最高の製品とサービスを提供し社員と社会に幸福を」という経営理念を掲げ、「エレクトロニクスの進化に挑戦し貢献する」という志のもと、事業展開を進めております。この度、2027年3月期を最終年度とする中期経営計画を策定いたしました。計画の概要としては、売上高2,500億円、営業利益275億円、親会社株主に帰属する当期純利益218億円といたしました。2022年3月期との比較では、売上高1,000億円増加、営業利益は約2倍となります。設備投資は5年間累計で1,000億円を投じ、お客様の需要増加に応じてまいります。

この中期経営計画では、車載用途をはじめ、スマートフォン・タブレット、半導体パッケージ、SSD・IoTモジュール、EMSなどでバランスのとれた成長を見込んでおりますが、中でも車載向け基板と半導体パッケージ基板を強化することといたしました。この分野は、今後さらに市場の急拡大が見込まれることから、重点投資を行い、収益性の向上を図ることにより体質強化を図り、営業利益率を8.8%から11%に高める計画を策定いたしました。

以上、中期経営計画に沿って収益性を高め、利益額の拡大を図ることによりさらなる成長と強固な財務体質へと転換し、企業価値の向上に努めてまいります。

車載向け基板の取り組み

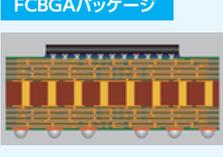
2027年3月期の計画達成に向けた主要な分野をご説明いたします。1つ目は車載向け基板です。この分野では、自動運転やEV化などにより大きく技術トレンドが変わり始めています。自動運転では、従来は、走る、止まる、曲がるといった基本的な機能を単独のECUで制御していました。これが自動運転となると走る、止まる、曲がるという機能を連携させる必要が出てきました。このためECUが複数の機能を持ち最終的には自動運転コンピューターとなっていきます。また、他の車両と連携する必要が出てくるため高速通信を行う基板も必要になってきます。これとは別に自動車のEV化も進展します。このため電子回路基板に求められる技術が変わってきます。当社はこうした変化に対応できる電子回路基板をすべてラインナップしており、また、今後必要となる技術を開発し、エレクトロニクスの進化に挑戦し貢献するべく体制を整えております。

高密度・高周波	小型化	放熱
ビルドアップ基板 (LVH Stack構造)  <ul style="list-style-type: none"> ●LVH接続による高密度配線 ●高密度配線による配線スペース小 ●LowDk/DF基材 	FR-4Flex構造 (Semi Flex)  <ul style="list-style-type: none"> ●FR-4.0, 4.1を使用した折り曲げ ●小型・省スペースへの組み込み 	厚銅構造 (Heavy Cu)  <ul style="list-style-type: none"> ●電流配線層厚銅化 6L貫通 内層105μm
AnyLayer構造  <ul style="list-style-type: none"> ●AnyLayer接続による高密度配線 ●AnyLayer接続による配線スペース小 ●LowDk/DF基材 	部品内蔵構造 (Embedded Devices)  <ul style="list-style-type: none"> ●基板内部へ部品内蔵し配線面積削減 ●発熱部品を放熱側へ内蔵し放熱効率UP 	銅インレイ構造 (Cu-Inlay)  <ul style="list-style-type: none"> ●銅インレイを通した部品の放熱 銅インレイ部表面写真
		MegaTH構造  <ul style="list-style-type: none"> ●選択THめっき厚付けによる放熱
		メタルベース構造 (Metal Base)  <ul style="list-style-type: none"> ●金属ベース構造での放熱 アルミ Cu

半導体パッケージ基板に参入

半導体需要の拡大を背景に、半導体パッケージ基板メーカーは最先端パッケージ基板への投資を拡大しておりますが、当社は小型のパッケージ基板分野に参入することいたしました。

日本国内は、SAP工法を用いたパッケージ基板を生産するため石巻第2工場での生産体制確立に取り組んでおり、この後に天童工場第2期投資で生産を拡大する計画です。ベトナムでは、ベトナム第3工場で、MSAP工法を用いて薄型パッケージ・モジュール基板の生産体制を確立し、この後にクアンミン第2工場で生産を開始する予定としております。

日本国内	ベトナム
SAP工法  FCBGAパッケージ 1.0mm程度 細線の追求	MSAP工法  メモリパッケージ 90μm程度 薄さの追求

生産体制

当社の電子回路基板は、開発から、設計、製造、実装までのワンストップサービスを提供しております。現在の電子回路基板生産を地域別で見ると、中国55%、ベトナム35%、日本10%の割合となっております。昨今は、新型コロナウイルス、自然災害、国際紛争など事業継続の妨げとなる事象がみられ、生産拠点の分散化が課題となりました。この度の中期経営計画では日本とベトナムの生産能力を強化することにより生産地域の分散化を図ります。中期経営計画最終年度の2027年3月期には中国40%、ベトナム42%、日本18%となります。中国市場は市場規模が大きく、今後の需要拡大を見込み需要に即した地産地消型に、ベトナムは成長著しいインド・アセアン地区を中心に欧米の需要に対応、日本は最先端の案件に応える体制としてまいります。

今年度、山形県天童市とベトナムハノイ市クアンミンで新工場の建設に着手いたしました。

山形事業所 天童工場 事業概要		クアンミン第2工場 事業概要	
所在地	山形県天童市	所在地	ハノイ市クアンミン工業団地
敷地面積	約65,000㎡	敷地面積	約63,000㎡
延床面積	約25,000㎡	延床面積	約20,000㎡
投資規模	約150億円/約250億円	投資規模	約100億円
事業内容	先端車載基板、PKG量産工場 基板技術開発センター機能 国内自動化設備開発・製造	事業内容	パッケージ・モジュール基板 最先端ビルドアップ基板

株主還元について

当社は、株主の皆様に対する利益向上を経営の重点課題の一つとしております。当面は、企業規模拡大のための投資を優先し、売上と利益額の拡大に注力いたします。配当性向の目安を15%といたしますが、利益額の拡大とともに配当額の増加を図ってまいります。

配当金

2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期(予想)
20円	45円	50円
第2四半期末 期末	0円 20円	第2四半期末 期末
	20円 25円	25円 25円

株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーのご支援、ご期待にお応えするべく、改善のための各々の施策に全力で取り組み、業績と企業価値の向上に努めてまいります。今後とも一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



取締役常務執行役員
梶 梗 芳 人

2022年3月期は年間を通じてコロナ禍の完全終息は見られず、半導体不足、資源、エネルギー価格の高騰等厳しい経営環境が続きましたが、幸いにもお客様に恵まれ全従業員の努力も加わり過去最高の売上、利益を計上することが出来ました。

4月には当社は新制度のプライム市場への編成替えが承認され、5月には初の5年間の中期経営計画を発表いたしました。

これからも国内外の投資をしっかりと行い引き続き車載、スマホの最先端基板に加え半導体パッケージ基板を新しい事業の柱の1つに育成してまいります。それに加えEMS事業も伸ばし、複数のアプリケーションを上手くバランスを取っていく戦略により、「エレクトロニクスの進化に挑戦し貢献する」という志を極めていきたいと考えております。

そして、プライム企業としてIR活動を強化し、投資家、ステークホルダーの皆様にはしっかり当社の成長戦略をご理解いただき、企業価値の最大化を図っていきたくと存じます。

今後とも引き続きのご支援を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

コーポレートデータ (2022年3月31日現在)

会社概要

商号	株式会社メイコー
設立	1975年11月25日
資本金	12,888百万円
従業員数	13,629名(連結) (国内855名・海外12,774名)
主な事業内容	電子回路基板等の設計、製造および販売ならびにこれらの付随業務に関する電子関連事業

役員

代表取締役社長執行役員	名屋 佑一郎
取締役専務執行役員	篠崎 邦也
取締役専務執行役員	和田 純也
取締役常務執行役員	松田 孝広
取締役常務執行役員	坂手 敦敦
取締役常務執行役員	梶 梗 芳 人
取締役執行役員	屋 茂
取締役執行役員	申 允 浩
取締役執行役員	土 屋 奈 生
取締役執行役員	西 山 洋 介
取締役執行役員	原 山 田
取締役執行役員	小 林 俊 文
常勤監査役	露 木 豊 彦
監査役	佐 藤 孝 幸
監査役	宮 内

関連会社

株式会社山形メイコー	電子関連事業
株式会社メイコーテック	電子関連事業
株式会社メイコーテクノ	電子関連事業
名幸電子(広州南沙)有限公司	電子関連事業
名幸電子(武漢)有限公司	電子関連事業
名幸電子香港有限公司	電子関連事業
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics America, Inc.	電子関連事業
Meiko Electronics Europe GmbH	電子関連事業
Meiko Towada Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業

株式情報

発行可能株式総数	70,000,000株
発行済株式の総数	25,780,277株 (自己株式 1,023,043株を除く)
株主数	4,337名

大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
名屋 佑一郎	4,703	18.25
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,951	11.45
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	2,204	8.55
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC /FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	1,025	3.98
CLEARSTREAM BANKING S.A.	1,012	3.93
名幸興産株式会社	608	2.36
有限会社ユーホー	521	2.02
名屋 精一	405	1.57
株式会社三井住友銀行	377	1.46
JP MORGAN CHASE BANK 385632	314	1.22

※当社は、自己株式1,023,043株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別株式分布状況(普通株式)



株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎ 0120-782-031
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場
公告の方法	電子公告により当社ウェブサイトに掲載 https://www.meiko-elec.com/ir/pa.shtml ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載

株式に関するお問合せ

- 住所変更、配当金受取り方法の変更等のお手続きは、お取引の証券会社にお問合せください。
- 証券会社の口座をご利用でない株主様、未払配当金のお手続きは、上記三井住友信託銀行証券代行部にお問合せください。



本社 〒252-1104 神奈川県横須市大上5-14-15 ホームページ <https://www.meiko-elec.com/>
TEL: 0467 (76) 6001 (大代表)

見直しに関する注意事項

本報告書に記載されている情報につきましては、当社の計画、業績など将来の見直しに関する記述が含まれており、これらの記述は、その時点で入手可能な情報および当社が合理的であると判断する一定の前提条件に基づいていす。実際の業績は、さまざまな要素により、これらと異なる結果となり得ることをご承知おきください。



この冊子は環境保全のため、植物油インキとFSC®認証紙を使用しています。見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。